

1934269-1 ✓ 有效

Z-PACK | Z-PACK TinMan

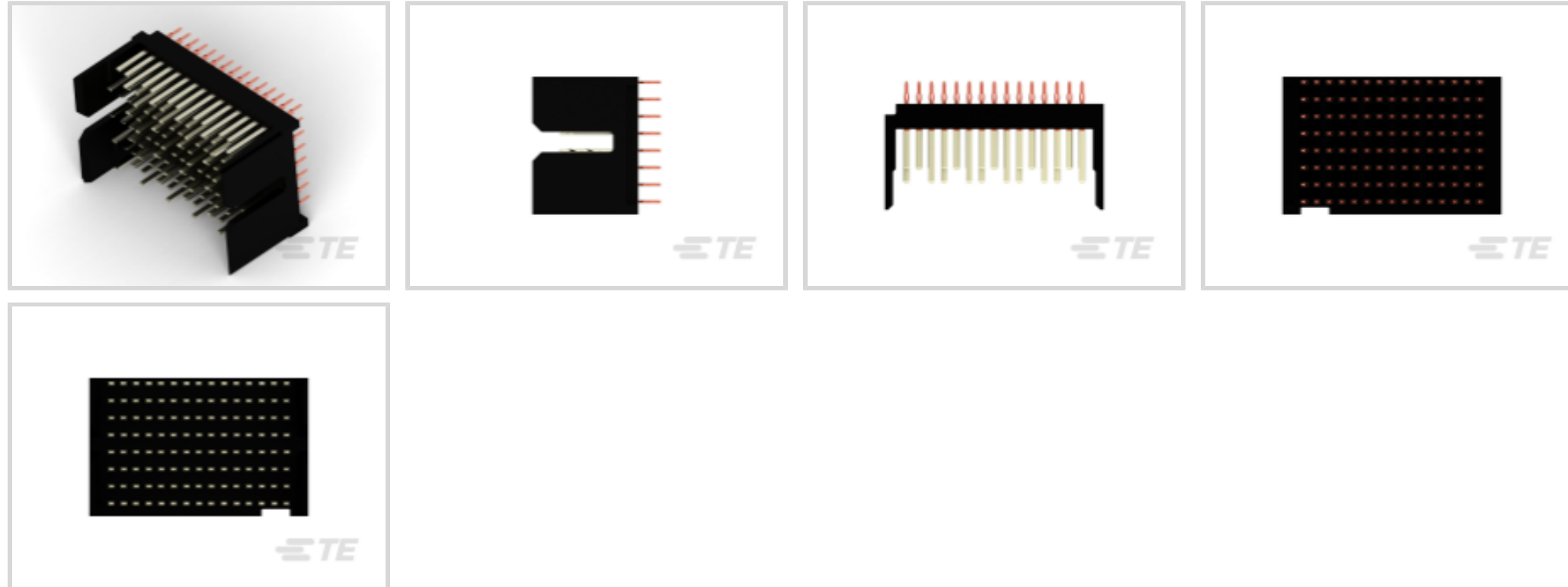
TE 内部编号 1934269-1

High Speed Backplane Connectors, 120 Position, Mating Alignment, Guide Slot Mating Alignment Type, 15 Row, 8 Column, PCB Mount Header, Z-PACK TinMan

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 高速背板连接器



位数: 120

行间距: 2.5 mm [.098 in]

接合对准: 带有

接合对准类型: 引导槽

行数: 15

产品特性

产品类型特性

背板模块类型	中心
信号排列	差分
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
护罩种类	部分带罩

结构特性

每列的对数	5
线对数量	40
可堆叠	否
信号位置数量	80
背板架构	传统背板
位数	120
行数	15



列数	8
----	---

PCB 安装方向	垂直
----------	----

电气特征

阻抗	100 Ω
----	-------

工作电压	250 VAC
------	---------

信号特征

差分阻抗	100 Ω
------	-------

每列的差分对数量	5
----------	---

数据速率	10 Gb/s
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子接触部长度	6 mm[.236 in]
---------	---------------

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.5 μm[20 μin]
------------------	---------------

端子类型	插针
------	----

端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[29.92 μin]
--------------	-------------------

端子接触部电镀材料	金
-----------	---

PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
--------------------	----

端子形状和构造	矩形
---------	----

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
----------------	---

端子基材	磷青铜
------	-----

端子额定电流（最大值）	.5 A
-------------	------

端接特性

端接柱体和尾部长度	2.5 mm[.098 in]
-----------	-----------------

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

机械附件

导轨硬件	不带
------	----

接合固定	不带
------	----

PCB 安装对准	不带
----------	----

PCB 安装固定	带有
----------	----

PCB 安装固定类型	作用/符合标准的尾
------------	-----------

接合对准	带有
------	----



接合对准类型	引导槽
连接器安装类型	板安装

壳体特性

有带罩的边数	2 - 侧面
端壁位置	开式
外壳材料	LCP (液晶聚合物)
中心线 (间距)	1.9 mm[.075 in]

尺寸

连接器长度	15.35 mm
连接器高度	11.8 mm
连接器宽度	24.4 mm
PCB 孔直径	.47 mm
行间距	2.5 mm[.098 in]

使用环境

工作温度范围	-65 – 90 °C[-85 – 194 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	Tube, 盒和管
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)



SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月
(240)
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

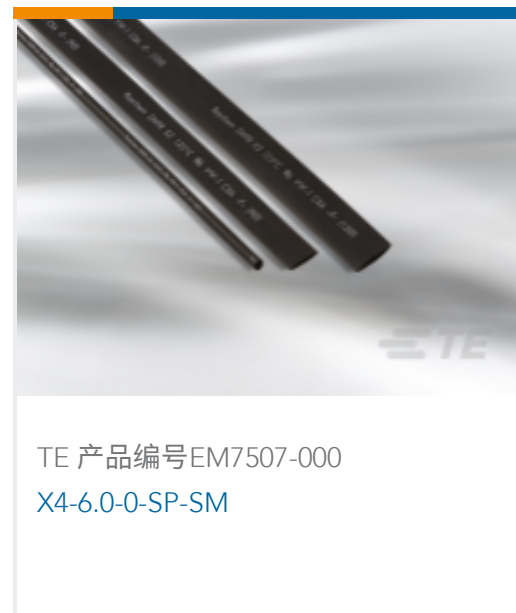
配套部件



该系列中的其他产品 | Z-PACK TinMan



客户还购买了



文档

产品图纸

[Tin Man Header Assy 5x8 Open](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_1934269-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1934269-1_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1934269-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页



[High Speed Backplane Connectors catalog - Z-PACK TinMan High Speed, High Density Backplane Connector](#)

英文版本

[High Speed Backplane Interconnect Solutions Brochure 1654263-1](#)

英文版本

[Z-PACK TinMan High Speed High Density Backplane Connector Catalog 5-1773447-9](#)

英文版本

[产品规格](#)

[应用规格](#)

英文版本